

インターネットネプコン 2023 出展のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では「第37回 ネットコンジャパン/半導体・センサ パッケージング展」に出展の運びとなりました。

ご紹介装置

- サーマル硬化型材料対応
 - ・ テンポラリーボンディング装置
 - ・ 機械剥離洗浄装置
 - ・・・TWH-BBD シリーズ
 - ・・・TWH-DBC シリーズ
- UV 硬化型材料対応
 - ・ マウンター、レーザーデマウンター
 - ・・・TWS シリーズ
- レジスト、PI、PZT 等塗布対応
 - ・ 汎用型スピコーター/デベロッパ
 - ・ ハイスループット型スピコーター/デベロッパ
 - ・・・CSX シリーズ
 - ・・・SPR シリーズ
- ナノインプリント
 - ・ 全自動ナノインプリント量産装置
 - ・・・Dyad™
- 角基板塗布
 - ・ FPD/PLP コーター
 - ・・・TZ シリーズ

都合により展示内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

日程・会場

会期：2023年1月25日（水）～27日（金）

会場：東京ビッグサイト 東1~3ホール ブース No.26-26

参考 WEB サイト

第37回 ネットコンジャパン 半導体・センサ パッケージング展

[ネットコンジャパン 公式 WEB サイト](#)

出展社：タツモ株式会社

[ネットコンジャパン](#) [出展社詳細](#) [タツモ\(株\)](#)

ご来場の際は、是非弊社ブースへお立ち寄り下さいます様、お願い申し上げます。